

## 詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與本公司及我們業務有關的若干技術用語。該等術語及涵義未必與標準行業定義或用法相符。

「ADAS」	指	先進駕駛輔助系統，旨在通過利用各種傳感器、攝像頭及軟件算法提供額外功能並增強駕駛體驗，協助駕駛員操作車輛並提升安全性
「AEC-Q」	指	汽車電子委員會 (Automotive Electronic Council) 資格標準，由AEC元件技術委員會制定，用於電氣元件及其資格要求
「AEC-Q100」	指	AEC-Q100標準，為一套嚴格的要求及測試，電子元件須通過有關要求及測試以確保其適用於汽車應用。AEC-Q100標準於汽車行業獲廣泛認可及採用，為車用電子元件設計及製造的重要考慮因素
「AI」	指	人工智能，即機器或計算機系統執行通常需要人類智慧的任務的能力
「AIoT」	指	人工智能物聯網，為AI與物聯網的結合
「AI Scaler」	指	基於ASIC的 scaler
「AMOLED」	指	主動矩陣有機發光二極管，一種高質量顯示技術，以更亮、更薄及更節能著稱
「ARM®」	指	高級精簡指令集機器 (advanced RISC machine)，一種以低功耗和高能源效率為核心目標的基於精簡指令集的處理器架構。ARM®為註冊商標
「ASIC」	指	針對特定應用需求定制的應用特定集成電路
「ASIL」	指	汽車安全完整性等級，為ISO 26262所界定的風險分類系統，該標準確定4個ASIL等級，即ASIL-A、ASIL-B、ASIL-C及ASIL-D，其中ASIL-D對產品的完整性要求最高，而ASIL-A的要求最低

## 詞彙表

「車規級」	指	車規級芯片指經專門設計、製造及認證以滿足汽車行業嚴格要求及標準(如AEC-Q100)的芯片
「BOM」	指	物料清單
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CPU」	指	中央處理器，作為電子產品運算及控制核心的集成電路
「DSC解碼」	指	顯示流壓縮，為降低通過接口傳輸高分辨率顯示數據所需的帶寬而開發的無損顯示壓縮標準
「EAL4+」	指	評估保證等級，由1至7級衡量安全評估，EAL4+代表商業安全解決方案可實現的最高等級之一
「端側AI」	指	一種結合AI能力與邊緣計算的技術範式，將AI算法及模型直接部署於邊緣設備(例如AIoT傳感器、智能手機、工業機器及其他本地計算設備)
「EMC」	指	電磁兼容性，電子設備及系統在其電磁環境中正常運作而不會造成或受到干擾的能力
「電動汽車」	指	電動汽車，一種完全或主要由電力驅動的車輛，通常使用電池及電動機代替內燃機
「無晶圓廠」	指	開發、設計及銷售半導體芯片，同時將其製造外包予外部相關方
「FLASH」	指	閃存，一種非易失性半導體存儲芯片，即使在斷電狀態下也能保留儲存的信息，具有可被反覆讀取、擦除和寫入的特性，被視為是存儲產品的一大類別
「FPGA」	指	現場可編程門陣列，一種可重新配置的半導體設備，可於製造後進行編程，以執行不同的邏輯功能
「HoD」	指	離手檢測
「Hz」	指	頻率單位

## 詞彙表

「集成電路」	指	集成電路，一組位於小塊半導體材料上的電子電路
「ISO」	指	國際標準化組織，為制定及發布標準的國際非政府組織，旨在確保各行業的質量、安全及效率
「ISO 26262」	指	國際汽車功能安全標準，適用於由硬件及軟件部件組成的電氣及電子系統
「L2」	指	二級智能駕駛，可協助駕駛員控制車速及轉向，例如通過保持駕駛員車輛與前車之間的距離幫助駕駛員通過交通擁堵路段，並提供轉向協助以維持車輛在車道中間行駛，期間要求駕駛員雙手緊握方向盤，並隨時準備接管車輛控制
「L3」	指	三級智能駕駛或有條件自動駕駛，該等級允許車輛自行駕駛，但僅限於理想及特定限制條件下，例如在高速公路的特定分道及停車場內以一定速度行駛，期間駕駛員無需手握方向盤，但必須坐在駕駛座內
「量產」	指	已量產解決方案指已通過開發及驗證流程、滿足客戶驗收標準，並準備就緒可大規模交付的解決方案
「MCU」	指	微控制器單元，一種整合微處理器核心、記憶體及周邊接口的芯片，通常用於控制嵌入式系統的運作，並廣泛應用於電子產品
「Mini LED」	指	微型發光二極體，一種採用微型LED芯片實現更細緻的局部調光的顯示器背光技術，使高端顯示面板呈現更高的亮度、更好的對比度，同時提升HDR表現
「Micro LED」	指	微發光二極體，一種由微米級LED陣列作為獨立像素的次世代自發光顯示技術，能實現超高亮度、廣色域、快速響應時間及長使用壽命，同時支持無縫模組化顯示
「nF」	指	納法拉，電容單位，代表一法拉(F)的十億分之一

## 詞彙表

「OEM」	指	原設備製造，即製造商根據客戶的設計及規格生產產品，並以客戶品牌名稱或無特定品牌進行市場推廣及銷售
「OLED」	指	有機發光二極管，一種有機材料直接發光以形成圖像的顯示技術，使屏幕實現更薄、更輕及高對比度
「PCB」	指	印刷電路板，帶有連接各種元件的電子電路的基板
「PCT」	指	專利合作條約，一項於1970年締結的國際專利法條約。其規定了提交專利申請的統一程序，以保護各締約國的發明。根據PCT提交的專利申請稱為國際申請或PCT申請
「RISC-V」	指	第五代精簡指令集計算架構，為一種開放、靈活、高效且創新的通用指令集架構
「研發」	指	研究及開發
「SAR」	指	比吸收率，用於計量無線電頻率場於特定質量組織中沉積的功率量
「Scaler」	指	一種圖像處理芯片，用於視頻格式轉換、分辨率及刷新率調整以及畫質增強
「STDI」	指	Scaler TDDI
「SoC」或「系統級芯片」	指	整合中央處理器、記憶體接口、片上輸入／輸出設備、輸入／輸出接口及次級存儲接口的可編程集成電路
「傳感器」	指	一種測量或檢測現實世界狀況(電容感知、壓力及溫度)並將其轉換為模擬或數字形式的設備
「TDDI」	指	觸控與顯示驅動集成，一種將觸控功能與顯示驅動整合於單一芯片的技術，可簡化顯示結構並提升性能
「流片」	指	集成電路最終設計完成後提交代工廠進行製造

---

## 詞彙表

---

「Tier 1 供應商」	指	直接向汽車OEM供應部件或系統的公司。汽車行業的其他供應商類型包括Tier 2及Tier 3供應商
「TMCU」	指	觸控MCU
「TPIC」	指	觸控一面板集成電路
「TWS」	指	真無線立體聲，一種無線音頻技術，可在音頻設備間建立立體聲系統而無需任何實體線路連接
「晶圓」	指	一種用於製造集成電路及其他微電子設備的半導體薄片